(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



A LOUIS BUINTER IN COURT SOM BOTH COURT DIN FRANCE BUINT BOTH COURT BOTH COURT BUILDING THAT HER FOREIGN

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 19. Mai 2005 (19.05.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer $WO\ 2005/044508\ A1$

(51) Internationale Patentklassifikation7:

B23K 26/38

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/009793

(22) Internationales Anmeldedatum:

2. September 2004 (02.09.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

03022635.1 6. Oktober 2003 (06.10.2003) EP 03024966.8 29. Oktober 2003 (29.10.2003) EP

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BECK, Thomas [DE/DE]; Jaegerstrasse 25d, 16341 Zepernick (DE). BOSTANJOGLO, Georg [DE/DE]; Odenwaldstrasse 17, 12161 Berlin (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

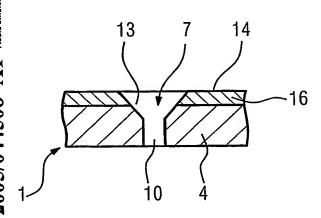
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\u00fcr \u00e4nderungen der Anspr\u00fcche geltenden Frist; Ver\u00f6fentlichung wird wiederholt, falls \u00e4nderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF A HOLE AND DEVICE
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES LOCHS UND VORRICHTUNG



- (57) Abstract: Previous methods for the production of a hole in a component are very time-consuming and expensive, as special lasers having ultra short laser pulse lengths are used. The inventive method varies laser pulse lengths and ultra short laser pulse lengths are used exclusively in the region which is to be removed, wherein it is possible to have a noticeable influence on through flow and/or out-flow behaviour. This is, for example, the inner surface of a diffuser (13) of a hole which can be produced in a precise manner using ultra short laser pulse lengths.
- (57) Zusammenfassung: Bisherige Verfahren zur Erzeugung eines Lochs in einem Bauteil sind sehr zeitaufwändig und kostenintensiv, da spezielle Laser mit ultrakurzen Laserpulslängen verwendet werden. Das erfindungsgemäße Verfahren variiert die Laserpulslängen, wobei ultrakurze Laserpulslängen nur in dem zu

entfernenden Bereich verwendet werden, in dem sich ein Einfluss auf das Durch- bzw. Ausströmungsverhalten bemerkbar macht. Dies ist z.B. die innere Oberfläche eines Diffusors (13) eines Lochs, das mit ultrakurzen Laserpulslängen sehr genau hergestellt werden kann.

